

Process Contamination

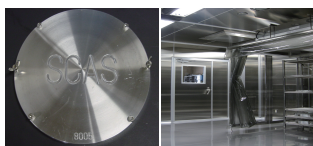
製造過程環境評估

使用基板採集法作製程污染評估

製造過程之微量有機物污染

基於多年來半導體製造污染之微量污染評估技術的開發，提供適用於設備製造過程（蒸鍍、塗布製程）之微量有機物污染評估服務。

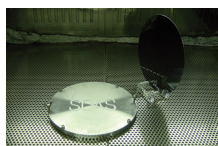
< 評估流程 >



專用盒 無有機污染 CR



運輸



專用檯

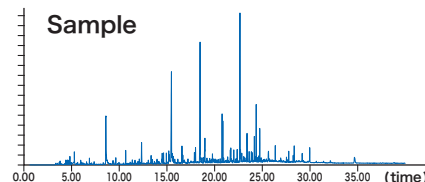
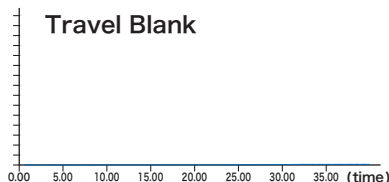


運輸



WTD-GC-MS

可以提供環境內所使用的採樣基板與潔淨的搬送專用盒。提供高準確度的環境污染評估，以利於管理運輸、處理上的污染影響。



*JACA No.35A Classification of Air Cleanliness for Airborne Molecular Contaminants (AMC) Level in Cleanrooms and Associated Controlled Environments and Its Measurement Methods.

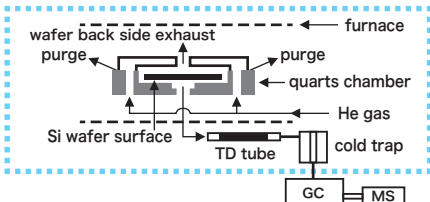
測定結果 (WTD-GC-MS)

Wafer 表面之有機物分析

在低壓環境中，相較於常壓環境下，可能存在有高沸點化合物。在此狀況下，可同時使用 LC-MS 進行全面污染物的分析。

Wafer Thermal Desorption GC-MS

- 方法：Wafer 加熱脫附 GC-MS 分析
- 對象：低沸點成分



- Wafer size : <math>< 300\text{mm}\phi \sim 50\text{mm}\square</math> (thickness : <math>< 2\text{mm}</math>)
- Measuring surface : One side
- Temp. : 400°C
- Target : C6 ~ C30 VOC
- Detection Limit : 0.001ng/cm² (C16 Convert @ 300mmφ)

溶媒抽出/LC-MS

- 方法：溶劑萃取/LC-MS 分析
- 對象：中 ~ 高沸點成分



- Wafer size : <math>< 200\text{mm}\phi \sim 50\text{mm}\square</math>
- Measuring surface : Both sides
- Extraction Temp. : 25°C
- Mass range : 100-2,000

< 分析目標成分與測定方法之對應圖 >

